

公司代码：688498

公司简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本85,947,726股，扣除目前回购专户的股份余额452,149股后参与分配股数共85,495,577股，以此计算合计拟派发现金红利8,549,557.70元（含税）。

如在报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上利润分配方案经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	源杰科技	688498	不适用

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程硕	吴晶
联系地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
电话	029-38011198	029-38011198
传真	029-38011198	029-38011198
电子信箱	ir@yj-semitech.com	ir@yj-semitech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为光芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，主要产品包括 2.5G、10G、25G、50G、100G、200G 以及更高速率的 DFB、EML 激光器系列产品和 50mW、70mW、100mW、150mW 等大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域，公司产品涵盖 1550 波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。

通过持续的研发投入构建差异化竞争优势，公司从电信市场收入为主的光芯片供应商，逐步发展国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

应用领域		速率	产品类型	
电信市场类	光纤接入	光纤接入 EPON	2.5G	1310nm FP
		光纤接入 GPON	2.5G	1310nm DFB
	光纤接入 10G PON		2.5G	1490nm DFB
		2.5G	1270nm DFB	
		10G	1270nm DFB	
		10G	1577nm DFB	
		10G	1577nm EML	
	光纤接入 25G/50G PON	10G	1577nm w/SOA	
		25G	1300nm DFB	
			25G	1286nm DFB

移动通信网络	4G 移动通信网络	25G	1358nm EML & 1358nm w/SOA EML	
		50G	1286/1342nm EML & 1286/1342nm w/SOA EML	
		10G	1310nm FP	
		10G	1310nm DFB	
	5G 移动通信网络	10G	1310nm Antireflection DFB	
		10G	1270~1570nm CWDM16 DFB	
		25G	1310nm FP	
		25G	10G overclock 1270~1370nm CWDM6 DFB	
		25G	1270/1330nm DFB	
		25G	1310nm DFB	
		25G	1270~1370nm CWDM6 DFB	
		25G	LWDM12 Channel DFB	
		25G	MWDM12 Channel DFB	
		50G	1270~1370nm CWDM6 DFB	
	数据中心类	数据中心	10G	1270~1330nm CWDM4 DFB
			25G	1270~1330nm CWDM4 DFB
			25G	LWDM4 Channel DFB
			50G	1270~1330nm CWDM4 PAM4 DFB
100G			1270~1330nm CWDM4 PAM4 EML	
100G			1304/1307/1309/1311nm Narrow LWDM PAM4 EML	
200G			1270~1330 CWDM4 PAM4 Single & Differential Drive EML	
CW			100mW 1310nm CW DFB	
CW			100mW CWDM4 CW DFB	
CW			70mW CWDM4/8 CW DFB	
CW			70mW 1310nm CW DFB	
CW			70mW LWDM4 CW DFB	
CW			50mW 1310nm CW DFB	
CW			25mW CWDM4 CW DFB	
CW			150mW 1310nm CW DFB	
车载激光雷达及传感	/	1550nm Pulse DFB		
	/	CH4 sensor		

注：

1、2.5G、10G、25G、50G、100G、200G 代表激光器芯片的传输速率；CWDM、LWDM、MWDM 代表可应用于波分复用网络的激光器芯片；PAM4 代表可应用于 PAM4 脉冲调制技术的激光器芯片；

2、报告期内，公司主要向客户销售激光器芯片，但为满足部分客户需求，公司会将激光器芯片封装后进行销售。

2.2 主要经营模式

1、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，设立市场与销售部负责开发客户、产品推广以及维护客户关系。市场与销售部根据客户需求情况制定销售计划，将接收到的订单需求反馈给生产与运营部，协调产品研发、生产、交付、质量等服务工作，同时承担跟单、售后、技术支持等工作。

新产品及客户导入方面，由于光芯片产品设计参数、性能指标多，公司市场与销售部根据客户需求先与其进行深度技术交流，研发部在此基础上进行产品设计、材料选型、样品生产等工作，然后在厂内进行样品性能测试、可靠性测试，并将样品送至客户处进行综合测试。测试通过后，客户会小批量下单采购，并在多批次生产合格后，转入批量采购。公司的成熟产品主要通过展会、现有客户推荐、销售经理开发等方式寻求新客户。

2、采购模式

每月月底采购部根据生产与运营部提供的次月生产计划及安全库存，制定对应的生产原物料采购计划（包括预测需求）；采购员根据采购计划向合格供应商下达 PO（采购订单），明确技术规格、交货周期及条款。建立 VMI（供应商管理库存）机制保障关键物料供应。IQC 部门依据 AQL（可接受质量水平）标准执行进料检验，采用 SPC（统计过程控制）方法监控关键质量特性，出具 COA（检验分析报告）作为放行依据。由仓管科负责核对到货单物料数量与采购订单物料数量，财务部负责最终付款。另外研发部门、生产类部门、厂务部门、行政部门等根据公司经营需要，制定相应各部门采购计划并提前传递采购部审核，由采购部统一采购。

公司制定供应商认证及供应商管理流程，对新的供应商进行资质评估及调查，对提供的样品进行验证，并进行合格供应商评审，合格的供应商将被录入《合格供方名单》。公司对供应商进行绩效考核并分级管理，按需进行物料替代管理、供应商稽核管理，确保公司的采购质量符合 ISO9001/14001 体系要求，确保采购活动满足 QCDS（质量/成本/交付/服务）综合目标。

3、生产模式

公司生产激光器芯片属于 IDM 模式，掌握芯片设计、晶圆外延等光芯片制造的核心技术，拥有覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试等自主生产的能力，公司的 IDM 模式能够缩短产品开发周期，实现光芯片制造的自主可控，快速响应客户并高效提供相应解决方案，能够迅速地应对动态市场需求。

公司生产以市场需求为导向，生产与运营部根据客户订单协调相关部门制定生产计划。公司根据年度销售策略进行产能评估，提前适当备货以应对需求高峰，保持库存的适度水平，减轻生产压力。

4、研发模式

公司研发以行业发展、应用需求及研发项目为基础，新产品研发流程以研发部《设计和开发控制程序》体系进行管理，从立项开始先后经历 6 个阶段，主要包括：立项、设计输入输出、工程验证测试（EVT）、设计验证测试（DVT）、研发转生产培训考核、批量过程验证测试优化（PVT）等阶段，各阶段要求满足后进入下一阶段，具体如下：

（1）立项阶段

市场与销售部根据客户及市场需求，提出新项目立项申请，填写《项目研发建议书》，并提交市场与销售部、研发部及总经理共同评审。项目评审通过后，指定项目负责人制作项目可行性分析，包括项目方案概况列举、项目预算、研发过程风险预估与对应措施，确定参与人员、明确客户指标需求等。

（2）设计输入输出阶段

项目负责人根据立项阶段资料，制作设计开发阶段指导文件及流程，包括产品技术参数、工艺指导文件、结构设计、工艺流程设计、环保分析、研发过程失效分析及对应的控制措施等。

(3) 工程验证测试阶段 (EVT)

研发部根据《设计和开发控制程序》要求进行投片，参照设计输入输出阶段工艺指导文件与流程进行样品试制，在试制结束后对客户需求指标进行测试分析。此阶段针对产品特性与工艺生产异常关闭率进行评审。第一轮样品试制若无法满足客户需求，研发项目团队总结样品试制过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，获得批准后进行下轮样品试制，直到满足客户需求后可转入下一阶段。

(4) 设计验证测试阶段 (DVT)

研发部根据投片数量进行设计验证测试，对客户需求指标进行测试并分析。此阶段针对产品稳定性与异常关闭率进行评审。设计验证测试结束若无法满足客户需求，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，从上一阶段的工程验证测试 (EVT) 开始开发，直到满足客户需求并通过验证。

(5) 研发转生产培训考核阶段

研发转生产培训考核阶段，研发部提供给生产与运营部相关资料，包括输出工艺标准指导书、工单、参数对照表、质检标准、标准工时统计表、试生产任务单等，并根据需求对生产线相应的人员进行培训与考核，通过评审后方可转入下个阶段。

(6) 批量过程验证测试优化阶段 (PVT)

批量过程验证测试优化阶段 (PVT)，生产与运营部接收研发转生产阶段文件后，评估产线产能、管理投入设备并分析人员、安全和环境等因素，确认具备量产能力后，制定并组织实施生产计划，投入资源进行批量验证与测试。在批量生产过程中，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，直到达到预期目标并通过验证。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段及基本特点

随着全球信息互联规模不断扩大，人工智能等技术的兴起，光电信息技术正在被进一步广泛应用。在这种趋势下，光芯片的下游应用场景不断扩展，需求量不断增加，同时对光芯片的速率、功率、传输距离也提出更高的要求。目前在电信市场、数据中心市场，光芯片都得到了较为广泛的应用，其中电信市场又可以细分为光纤接入和移动通信两个细分领域。

电信市场：2024 年，5G、千兆光纤网络等新型基础设施建设进一步完善。在光纤接入市场：截至 2024 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.7 亿户，全年净增 3,352 万户。其中，1000Mbps 及以上接入速率的用户为 2.07 亿户，全年净增 4,355 万户，占总用户数的 30.9%，占比较上年末提高 5.2 个百分点。固定互联网宽带接入端口数达到 12.02 亿个，比上年末净增 6,612 万个。其中，光纤接入 (FTTH/O) 端口达到 11.6 亿个，比上年末净增 6,570 万个，占比由上年末的 96.3% 提升至 96.5%。截至 2024 年底，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2,820 万个，比上年末净增 518.3 万个。在无线通信领域，5G 网络建设深度覆盖。截至 2024 年底，全国移动电话基站总数达 1,265 万个，比上年末净增 102.6 万个。5G 基站为 425.1 万个，比上年末净增 87.4 万个。5G 基站占移动电话基站总数达 33.6%，占比较上年末提升 4.5 个百分点。随着无线和光纤接入部署逐步进入成熟期，下一代技术逐步开始布局。光纤接入领域开始向“万兆”加速。作为 ITU-T 定义的下一代 PON 技术，50G PON 比 10G PON 带宽提升了 5 倍、时延降低了 100 倍，具备提供确定性业务体验的能力。根据工信部《关于开展万兆光网试点工作的通知》的内容，到 2025 年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。以试点工作为牵引，推动产业链各方加快协同解决目前万兆光网落地应用中的重点难点问题，带动我国万兆光网核心技术和关键设备取得突破，促进构建万

兆光网成熟产业链和完备产业体系，有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用。同时，由于 5G-A 在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升，引入了通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术，能更好地匹配人联、物联、车联、高端制造、感知等场景。运营商也逐步推进其商用部署或组网试点。相关技术的成熟与推广，有望对相关的产业链形成拉动作用。

数据中心市场：随着人工智能的快速发展，模型性能提高，需要大量算力，导致对光器件的需求、能力的增加。在这样的背景下，数据中心市场高速率需求持续增加。2024 年，国内外 CSP 对 AI 基础设施的投资推动 400G/800G 以太网光模块出货量激增，进而拉动光芯片的需求。这一投资趋势在 2025 年持续加强，同时中国云厂商也开始进一步的跟进。在速率方面，2025 年 1.6T 光模块将开始批量出货。随着交互速率及训练集群规模的提升，业界对功耗、散热、成本提出了更高要求，因此系统互联互通的方式需要不断优化，以实现更高的能效比和更紧凑的封装设计。低功耗、小型化、集成化将成为未来光模块发展的重要趋势。目前，硅光技术在可插拔光模块中逐步提升，特别在高速率模块中应用渗透率进一步加大。LPO 方案也是未来趋势，其在特定场景中表现出较低功耗和成本的优势。进一步来看，未来 CPO、OIO 的发展和应用，也将带来更多光互联领域的新增量。Light Counting 在最新报告中指出，光通信芯片组市场预计将在 2025 至 2030 年间以 17% 的年复合增长率（CAGR）增长，总销售额将从 2024 年的约 35 亿美元增至 2030 年的超 110 亿美元。

(2)主要技术门槛

更高速率、更高功率、更长传输距离的光芯片的技术研发、工艺设计具有更高开发难度与门槛。一方面，随着需求提升，光芯片的结构设计的精度要求极高，技术研发及工艺开发需结合高速射频电路与电子学、微波导光学、半导体量子力学、半导体材料学等多学科，设计合适的芯片结构，满足芯片精度及尺寸的要求；另一方面，激光器芯片的生产需要几十至几百道工序，每道工序都将影响产品最终的性能和可靠性，因此对生产线工艺成熟和稳定有极高要求。此外，高速率激光器芯片相较于中低速率产品，在量子阱有源区、光栅层结构区、模斑转化器区域、光波导结构区、电流限制结构区、高频电极结构、谐振腔反射膜等关键结构的设计与开发上，需综合考虑光电特性、产品可靠性、制备工艺可行性等相互制约因素，因此存在极高壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。通过研发、市场、服务、产品等多个维度的协同发展，公司已经获得国内客户的认可，并从电信市场收入为主的光芯片供应商，逐步发展国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

在电信市场中，目前所需的 2.5G、10G 激光器芯片市场国产化程度较高，但不同波段产品应用场景不同，工艺难度差异大，公司凭借长期技术积累实现激光器光源发散角更小、抗反射光能力更强等差异化特性，为光模块厂商提供全波段、多品类产品，同时提供更低成本的集成方案，实现差异化竞争；未来 25G/50G PON 接入网对光芯片的要求也将进一步提升，大功率、低色散、高速调制的场景需求提升了光芯片的技术门槛，公司已开发相应的集成技术与光放大器集成技术平台，适配高速接入网的需求，使公司的 PON 光芯片产品具备更强的市场竞争力，进入下一代高速需求的迭代过程。

在数据中心市场中，尤其是以人工智能为代表的應用拉动了 400G、800G 或以上高速光模块的需求增加，进而带动了高速率、大功率的芯片需求，比如主要为 100G PAM4 EML 光芯片、70mW、100mW 大光功率激光器等。目前数据中心市场仍以海外供应商为主。公司基于多年在

光芯片领域的研发和生产积累，已推出相应的高速 EML、大功率激光器产品，无论是单波或是多波长的 CWDM、LWDM 需求，来适配相关的高速光模块的需求，且性能及可靠性等指标可对标海外同类型产品。目前，公司在 AI 数据中心市场实现销售突破。尤其是硅光模块解决方案所需的全系列大功率 CW 激光器产品，2024 年面向 400G/800G 硅光模块的 CW 芯片产品已实现百万颗以上出货，奠定了公司在该领域较为领先的行业地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 硅光技术逐渐成为提升成本效率重要方案之一

降本、降功耗、增效始终是算力发展过程中不断追求的方向。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有 CMOS 工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。AI 的爆发大幅提升了对光模块速率和数量的需求，使得降本降功耗更为紧迫，这导致了客户对硅光的接受度有望提升。目前，硅光方案的光模块在 400G 和 800G 的渗透率有明显的提升，下一代 1.6T 的光模块中，硅光方案占比将进一步提升。在硅光方案中，CW 激光器芯片作为外置光源，硅基芯片承担速率调制功能。CW 大功率激光器芯片，要求同时具备大功率、高耦合效率、宽工作温度的性能指标，对激光器芯片要求更高。

(2) 关注 CPO 等新技术的演进

随着单通道速率提升，电链路距离越长损耗越大，需要将光引擎更靠近交换芯片。因此，CPO 技术通过将交换芯片和光引擎封装在一起，缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，从而帮助电信号在芯片和引擎之间更快地传输，减少尺寸，提高效率，降低功耗。从目前 CPO 相关技术路径构架来看，在 CPO 交换机中 CW 光源单颗价值量将提升，同时所需要的功率也将进一步提高。

(3) 光芯片下游应用市场不断拓展

光芯片的应用领域正在不断拓展。在传感领域，如环境监测、气体检测，光芯片被用作传感器，能够检测光信号并转换为电信号，用于数据采集和分析。在汽车领域，随着传统乘用车的电动化、智能化发展，高级别的辅助驾驶技术逐步普及，核心传感器件激光雷达的应用规模将会增大。基于砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP) 的光芯片作为激光雷达的核心部件，其未来的市场需求将会不断增加。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减 (%)	2022年
总资产	2,147,544,868.83	2,236,682,340.61	-3.99	2,295,683,768.92
归属于上市公司股东的净资产	2,072,766,453.62	2,116,687,842.73	-2.08	2,102,471,916.64
营业收入	252,172,673.21	144,403,649.04	74.63	282,905,278.42
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	252,104,151.44	144,045,936.03	75.02	282,847,024.38

入				
归属于上市公司股东的净利润	-6,133,875.94	19,479,815.27	-131.49	100,316,964.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,426,044.66	-238,669.33		91,866,664.92
经营活动产生的现金流量净额	18,960,995.49	-17,399,733.48	不适用	37,739,184.13
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	0.92	减少1.21个百分点	14.99
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93	2.23
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93	2.23
研发投入占营业收入的比例(%)	21.62	21.43	增加0.19个百分点	9.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	60,063,175.77	60,095,690.92	58,018,943.68	73,994,862.84
归属于上市公司股东的净利润	10,534,967.18	216,324.83	-11,301,423.15	-5,583,744.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,570,094.24	-99,849.95	-13,823,807.50	-7,072,481.45
经营活动产生的现金流量净额	22,407,486.05	-9,560,251.70	-21,693,914.15	27,807,675.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,540
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	-

股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）		-					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）		-					
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
ZHANG XINGANG	-	10,562,958	12.36	10,562,958	无	-	境外自然 人
秦燕生	-	4,604,859	5.39	4,604,859	无	-	境内自然 人
秦卫星	-	4,478,859	5.24	4,478,859	无	-	境内自然 人
苏州瑞璜股权投资 管理合伙企业（有 限合伙）—宁波创 泽云投资合伙企业 （有限合伙）	-836,359	3,389,618	3.97	-	无	-	其他
张欣颖	-	2,944,053	3.44	2,944,053	无	-	境内自然 人
陕西科迈投资管理 合伙企业（有限合 伙）—陕西先导光 电集成科技投资合 伙企业（有限合伙）	-	2,367,225	2.77	-	无	-	其他
全国社保基金二零 二组合	未知	1,671,217	1.96	-	无	-	其他
国投创业投资管理 有限公司—国投 （宁波）科技成果 转化创业投资基金 合伙企业（有限合 伙）	-561,104	1,644,652	1.92	-	无	-	其他
杭州汉京西成创业 投资合伙企业（有 限合伙）	-2,681,396	1,495,000	1.75	-	无	-	境内非 国有法 人

中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,081,072	1,282,863	1.50	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、ZHANG XINGANG 和张欣颖系兄妹关系； 2、秦燕生和秦卫星系兄弟关系； 3、ZHANG XINGANG 与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人； 4、ZHANG XINGANG 与欣芯聚源为一致行动人； 5、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

存托凭证持有人情况

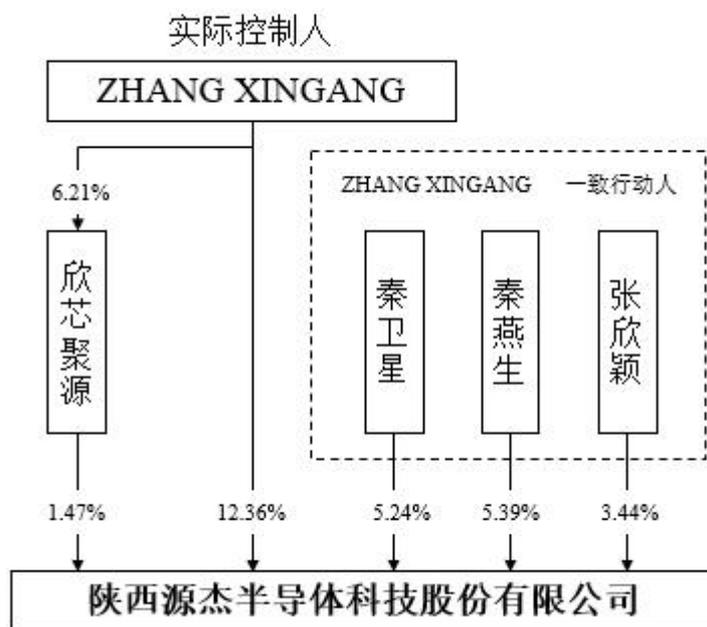
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入 25,217.27 万元，同比增加 74.63%；归属于母公司所有者的净利润-613.39 万元，同比下降 131.49%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,142.60 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用